



※本画像は参考用であり、予告なく変更される場合があります。
The illustration is for reference and subject to change without notice

RDL + Micro Bump 検査対応
L/S : 2 μ m/2 μ m & Bump size : 10 μ mを高精度検査
High-Precision Inspection for RDL and Micro Bump
Supports L/S: 2 μ m/2 μ m and Bump Size: 10 μ m

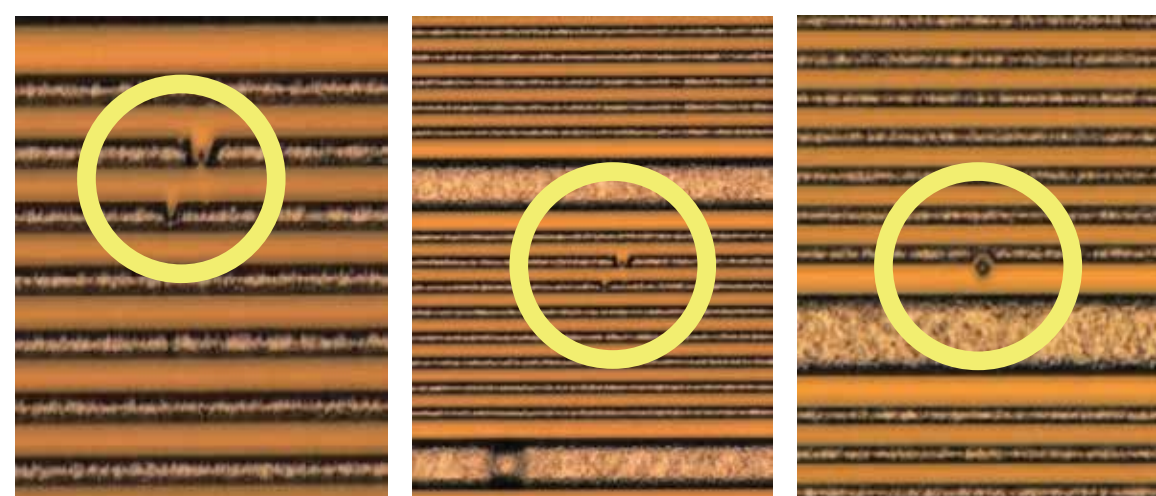
高分解能 2D・3Dイメージング

2D分解能 最大 225 nm／画素 (20倍対物レンズ時)
2倍: 2.25 μ m | 5倍: 0.922 μ m | 10倍: 0.45 μ m
3D分解能 2倍: 2.8 μ m | 5倍: 1.1 μ m | 10倍: 0.6 μ m

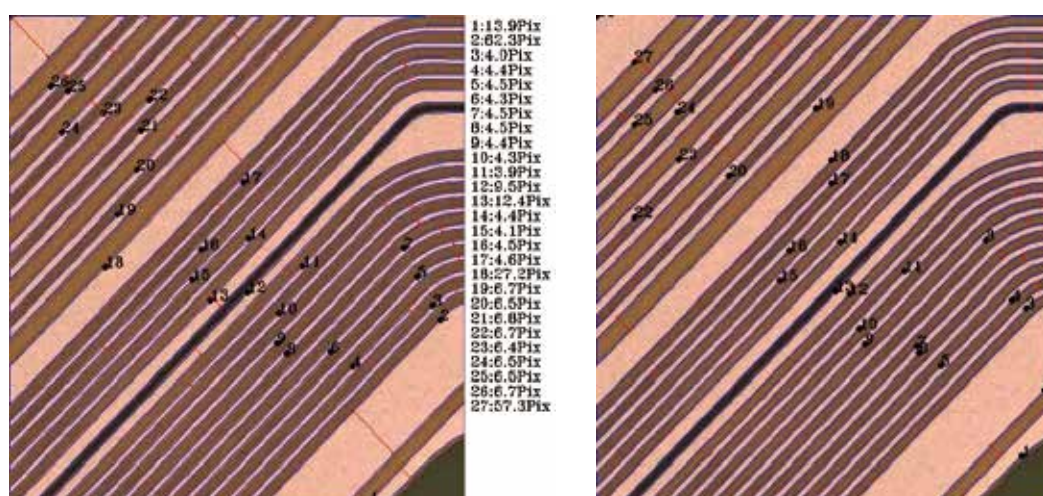
**6/8/12インチウェハおよび
大型PLP (600×600mm／310×310mm) 対応**
Supports 6/8/12 inch Wafers or Large-Size PLP (600×600mm/310×310mm)

フルカラー撮像とオートフォーカス機構による、AI＋従来技術融合の高精度検査システム Full-Color Imaging + Auto-Focus System & Fully AI+Traditional-Based Inspection

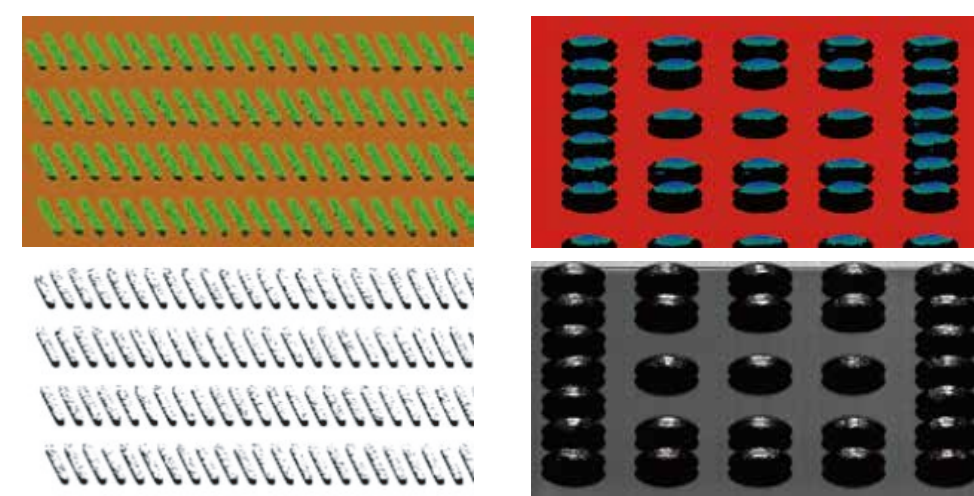
AIが実現する高精度2D検査と3D計測ソリューション AI Based 2D Inspection + 3D Metrology



RDL Micro Defect



RDL L/S Metrology

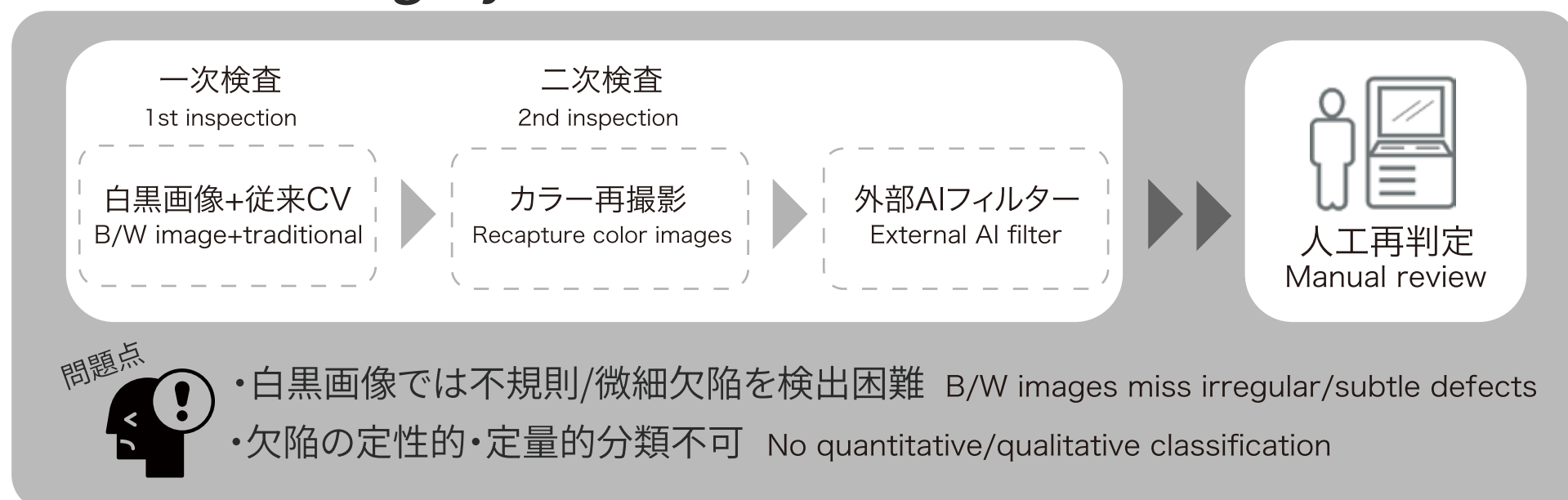


Bump 3D/2D Metrology

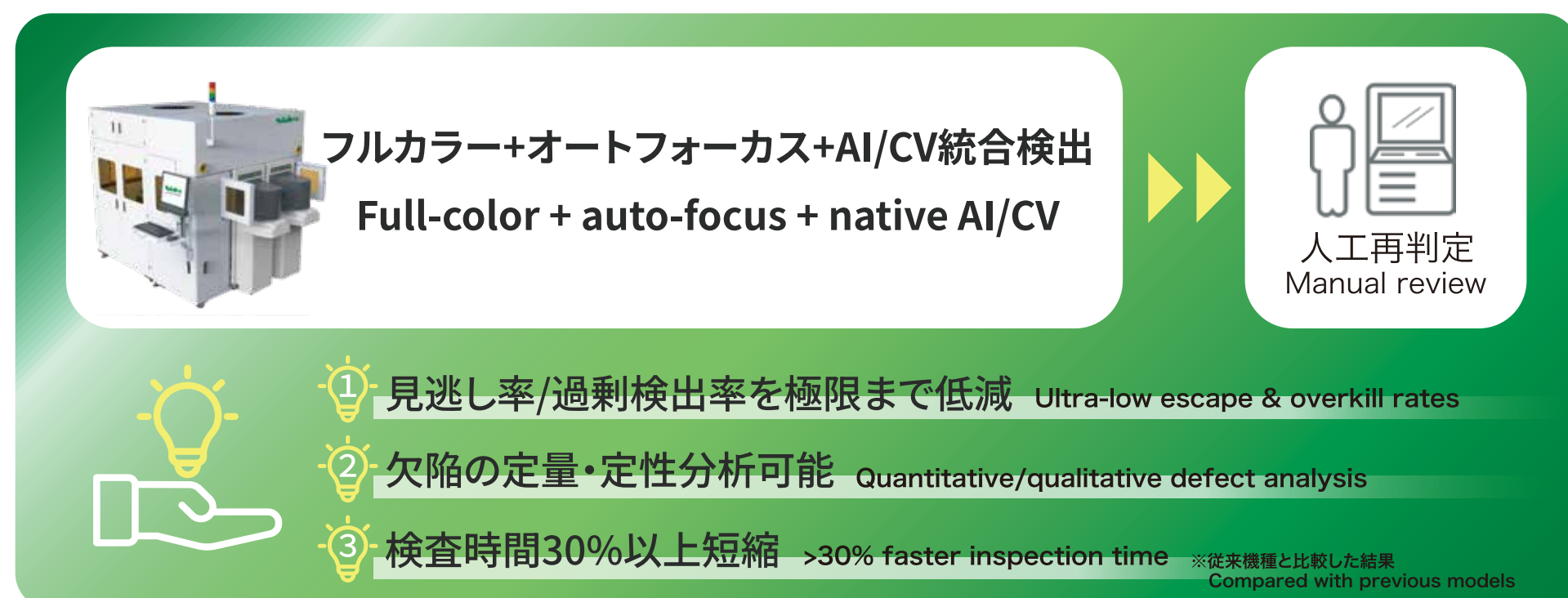
NIDECソリューション — 従来方式を超える新たな価値 NIDEC Solution vs. Legacy Solution

Key Specifications

従来方式 Legacy Solution



NIDEC AI Solution



2D Inspection

対応可能なサイズ Product Size	6/8/12インチウェハ・最小厚み100 μ m対応 600×600/310×310mmパネル 6/8/12-inch wafers; minimum wafer thickness: 100 μ m 600×600/310×310mm Panel
精度 Resolution	2x: 2.25 μ m 5x: 0.922 μ m 10x: 0.45 μ m 20x: 0.225 μ m (Option) *Higher precision is optional
検出欠陥 Defect Type	配線欠陥: 断線/短絡/欠け/金属残留/線幅異常 バンプ欠陥: 表面不良/寸法異常/欠落・位置ズレ TSV欠陥: 金属・粒子汚染/変形/寸法異常 その他: 欠け/残膠/圧痕/異物/キズ/酸化/腐食/フィルム割れ/輝点 Line defects: Opens, shorts, notches, metal residues, CD variations Bump defects: Surface anomalies, dimensional deviations, missing/misaligned bumps TSV defects: Metal/particle contamination, deformation, dimensional deviations Other defects: Edge chipping, residual glue, indentations, foreign materials, scratches, oxidation, corrosion, film cracks, bright spots

3D/2D Metrology

バンプ仕様 Bump Specification	Solder/Pillar/Au Bump		Lens 2x	Lens 5x	Lens 10x (Option)
	Bump Size	Min.	φ13μm	φ10μm	φ8μm
		Max.	φ500μm	φ250μm	φ125μm
	Bump Pitch	Min.	1.4×Bump ht	1.4×Bump ht	1.4×Bump ht
	Bump Height	Min.	0μm	0μm	0μm
Max.		300μm	100μm	50μm	
機能 Functions	リアルタイム歩留まり監視+データ統計分析+SECS/GEM300準拠+MES連携 +Class 10クリーン度				
	Real-time yield monitoring+Data analytics+SECS/GEM300 protocol +MES integration+Class10 cleanliness				

国内拠点

・京都(本社)
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION